



RE900-02

- Epoxydglashartgewebe FR4 1,50 mm
- Zweiseitig 35 µm Cu
- Durchkontaktiert (PTH)
- Oberfläche chem. Ni/Au mit Lötstopplack beschichtet
- Adaptionplatine für TSOP I 28, 32, 40, 48 (0,50 mm)
- Lochdurchmesser 1,00 mm
- Gerberdaten zur Herstellung des Lötpastenaufdrucks werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt
- Größe 26,50 x 43,64 mm

| Modul-Nr. | Typ | Pitch | Pin | Größe (mm) |
|-----------|--------|----------|----------------|---------------|
| RE900-02 | TSOP I | 0,500 mm | 28, 32, 40, 48 | 12,00 x 20,00 |